



令和6年11月7日

広島大学で日米11大学が半導体の未来を議論
第3回 UPWARDS 日米合同会議を日本初開催

情報提供

広島大学は、2024年11月14日、日米11大学およびマイクロン、東京エレクトロンによる日米半導体連携パートナーシップ事業「UPWARDS for the Future」の第3回日米合同会議を開催いたします。本会議は、第1回目は2023年10月18日に米国パデュー大学主催で、第2回目は2024年4月24日に米国ワシントン大学主催で開催され、日本での開催は今回が初となります。本事業は、半導体分野での次世代人材育成と研究開発を強化することを目的とし、2023年5月のG7広島サミットでの覚書締結により始動しました。

本事業では、日本5大学と米国6大学が協力し、5年間にわたって半導体技術の発展と多様な人材の育成を目指します。重点取組として、(1)カリキュラムデザイン、(2)半導体分野での女性支援、(3)体験学習(ラボ実習)、(4)非知財の研究開発、(5)学生・教員交流、の5つの柱が設定されています。

このたびの会議では、UPWARDSに参画する日米11大学に加え、スポンサー企業であるマイクロンおよび東京エレクトロンからおおよそ70人の関係者が集まり、これまでの成果を振り返り、長期的なビジョンを共有するとともに、次回会議までに取り組むアクションプランを策定します。

会議前日には、マイクロン広島工場の視察も予定され、参加者にとって先端技術の現場を実際に見学する貴重な機会となります。また、会議翌日には、広島大学半導体産業技術研究所が主催する国際ナノデバイステクノロジーワークショップ2024(IWNT2024)が東広島市芸術文化ホールで開催されます。

広島大学は、半導体教育研究拠点として国内の国立大学で最も長い歴史を育んできました。2023年4月には産官学で半導体開発に取り組む「せとうち半導体共創コンソーシアム」の拠点を東広島キャンパスに開設するなど、半導体の研究開発を重要な戦略事業の柱と位置付けています。UPWARDSの強固なパートナーシップを通じて、日米の半導体技術の多様化・高度化と専門人材の育成に一層貢献してまいります。

【概要】

日 時 : 2024 年 11 月 14 日 (木) 09:00~16:30
会 場 : 広島大学東広島キャンパス 学士会館 2 階レセプションホール
言 語 : 英語

【プログラム】

時間	プログラム
09:00-09:20	会議前のコーヒブレイク
09:20-09:30	開会挨拶 マイクロン・Director, Strategic University Partnerships Janine Rush-Byers 氏
09:30-12:00	全体セッション
12:00-13:30	昼食休憩
13:30-15:00	分科会セッション
15:00-16:00	総括セッション
16:00-16:30	閉会挨拶 広島大学理事・副学長（グローバル化担当）金子慎治

【UPWARDS for the Future 参画大学】（アルファベット順）

日本 5 大学: 広島大学、九州大学、名古屋大学、東北大学、東京科学大学
米国 6 大学: ボイシ州立大学、パデュー大学、レンセラー工科大学
ロチェスター工科大学、ワシントン大学、バージニア工科大学

**【お問い合わせ先】**

国際室国際部グローバル化戦略グループ 吉盛・渡邊
TEL: 082-424-4621/3505

発信枚数: A4 版 3 枚 (本票含む)

(別紙)

【FAX返信用紙】

FAX：082-424-6040

広島大学広報室 行

広島大学で日米11大学が半導体の未来を議論
第3回 UPWARDS 日米合同会議を日本初開催

日時：2024年11月14日(木) 09:00～16:30
会場：広島大学東広島キャンパス 学士会館2階レセプションホール

☐ ご出席

☐ ご欠席

貴社名 _____

部署名 _____

ご芳名 _____ (計 人)

電話番号 _____

誠に恐れ入りますが、上記にご記入頂き、11月13日(水)12:00まで
にご連絡願います。